

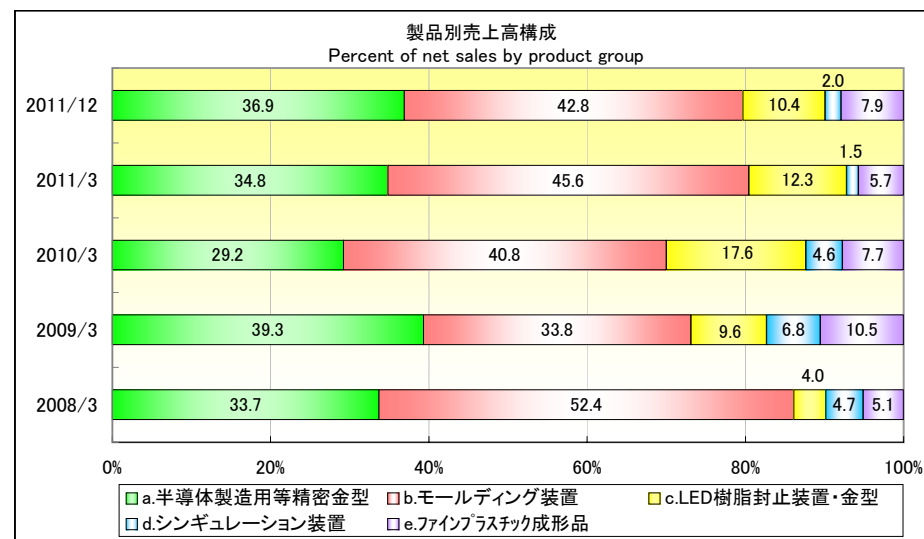
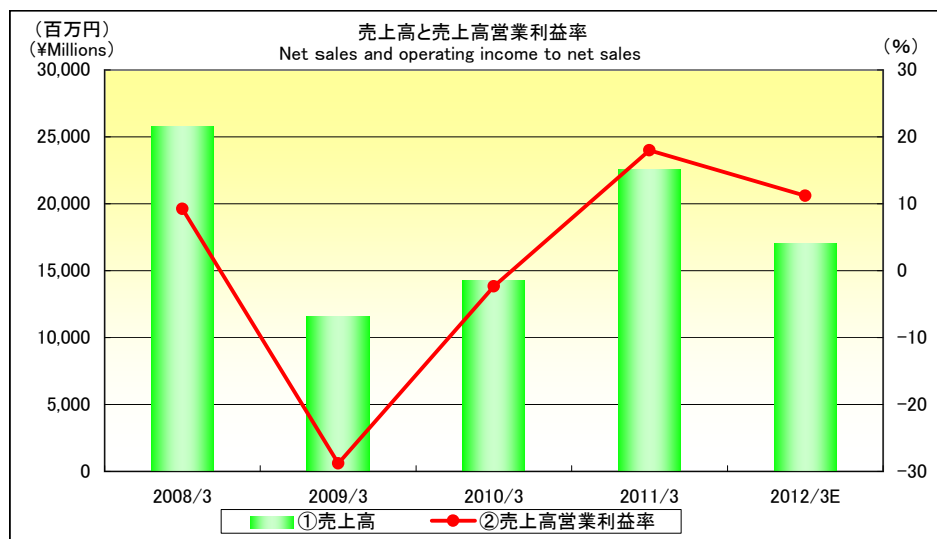
2012年3月期 第3四半期決算補足資料 (2012年2月)



TOWA株式会社

東証1部・大証1部:6315

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



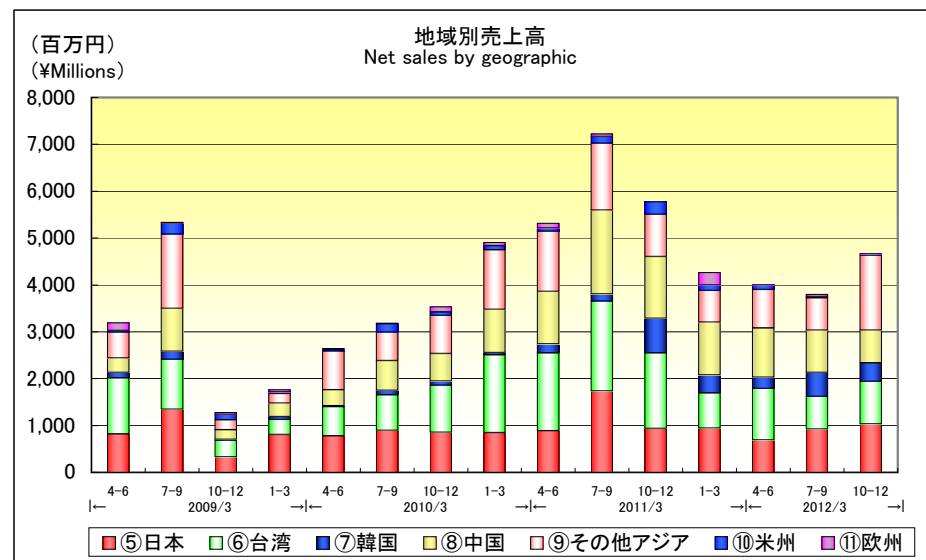
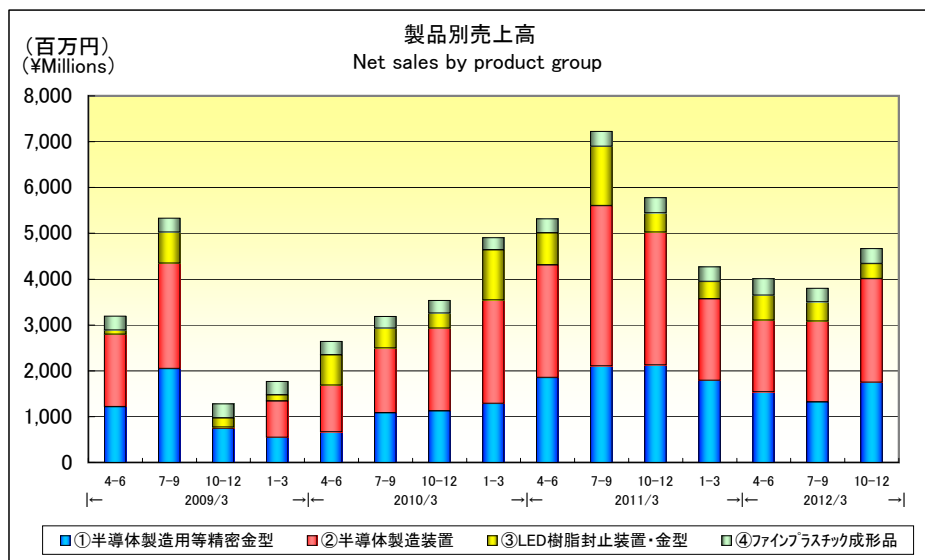
a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2011/12	2012/3E
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions						
売上高	①Net sales	25,753	11,577	14,274	22,592	12,479	17,000
営業利益	Operating income	2,381	-3,337	-338	4,067	1,360	1,900
経常利益	Ordinary income	2,125	-3,677	-345	4,064	1,277	1,750
当期純利益	Net income	2,118	-4,163	-330	3,751	631	1,100
総資産	Total assets	34,360	27,949	26,738	27,288	25,645	-
純資産	Net assets	16,394	11,089	11,091	14,771	15,292	-
1株当たり指標	Per share data						
1株当たり当期純利益	Net income per share	84.70	-166.45	-13.19	150.00	25.25	43.98
諸指標	Data						
自己資本当期純利益率	Return on equity	13.5	-30.3	-3.0	29.0	4.2	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	6.1	-11.8	-1.3	15.0	4.8	-
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	9.2	-28.8	-2.4	18.0	10.9	11.2
自己資本比率	Equity ratio	47.7	39.7	41.5	54.1	59.6	-

(単位: 百万円/¥Millions)

	2010/9	2011/9
	12,544	7,813
	2,691	764
	2,625	571
	2,515	-36
	28,378	25,637
	13,291	14,531
	100.55	-1.44
	20.6	-0.2
	9.5	2.2
	21.5	9.8
	46.8	56.7

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



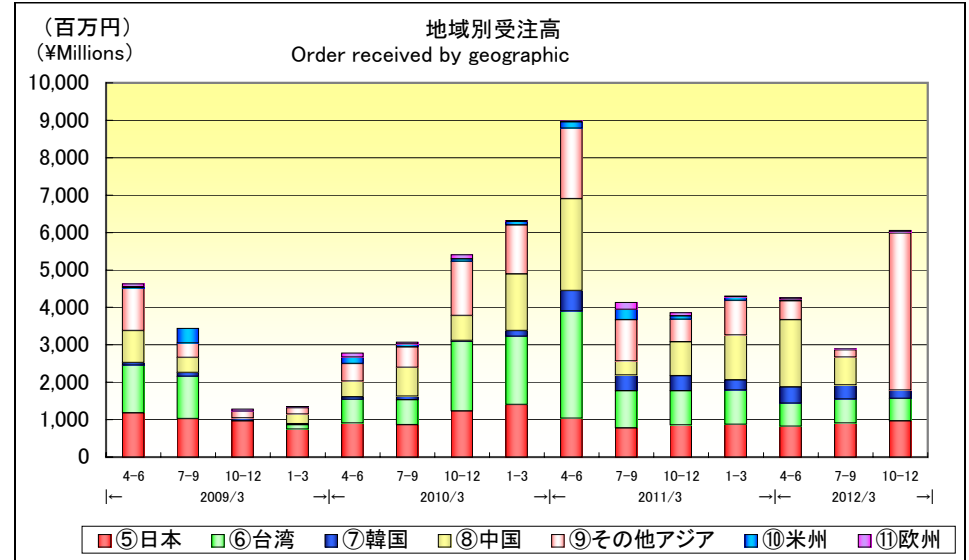
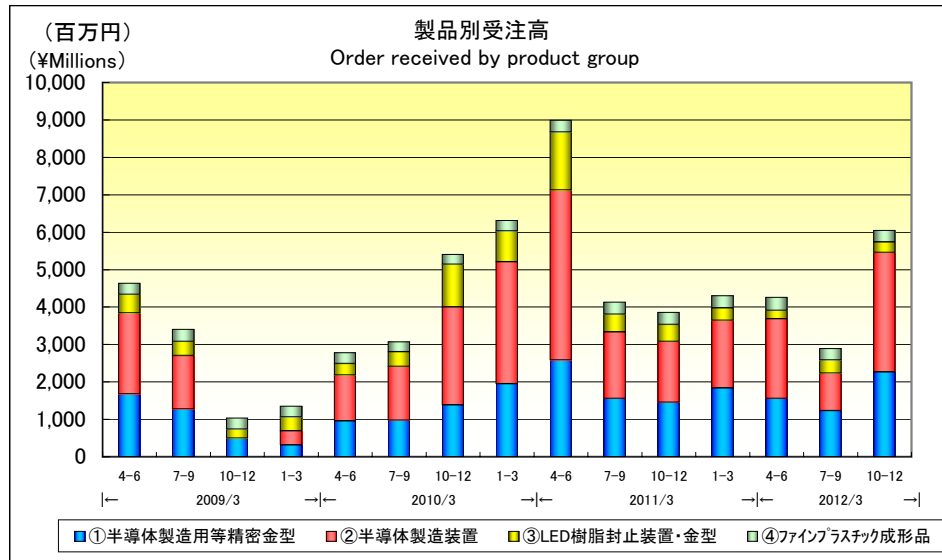
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	3Q累計	
売上高合計 Total sales	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	12,479	
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,218	2,046	739	547	4,552	665	1,086	1,127	1,287	4,167	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866	1,537	1,320	1,745	4,603	
半導体製造装置 ②Semiconductor manufacturing equipment	1,575	2,299	29	796	4,700	1,021	1,407	1,801	2,253	6,484	2,462	3,499	2,902	1,786	10,651	1,568	1,761	2,263	5,593	
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	95	681	202	128	1,107	659	435	325	1,100	2,520	698	1,290	420	377	2,786	544	418	333	1,296	
ファイナプラスチック成形品 ④Engineering plastic molded products	302	307	310	295	1,217	293	261	283	263	1,102	304	332	332	319	1,289	359	303	323	985	
月平均	1,064	1,778	428	589	965	880	1,063	1,179	1,635	1,190	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883	1,336	1,268	1,555	1,387	

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	3Q累計	
売上高合計 Total sales	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	12,479	
日本 ⑤Japan	820	1,347	329	805	3,302	782	892	856	847	3,379	889	1,735	936	943	4,507	688	925	1,030	2,644	
アジア太平洋 Asia pacific	2,177	3,740	794	876	7,587	1,811	2,100	2,492	3,900	10,305	4,253	5,290	4,572	2,938	17,060	3,215	2,797	3,605	9,618	
(内 台湾) ⑥Taiwan	1,195	1,067	355	325	2,943	618	763	1,002	1,660	4,044	1,661	1,920	1,611	751	5,945	1,103	695	912	2,711	
(内 韓国) ⑦Korea	118	166	18	58	362	22	92	92	45	253	187	152	737	380	1,458	237	510	393	1,141	
(内 中国) ⑧China	309	919	209	287	1,726	341	635	585	926	2,490	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363	1,050	903	701	2,655	
(内 その他アジア) ⑨Other asia	553	1,587	210	204	2,555	829	608	811	1,267	3,516	1,279	1,431	904	675	4,291	823	688	1,598	3,109	
米州 ⑩America	31	226	115	36	409	29	182	74	95	382	70	145	268	117	602	94	32	25	153	
欧州 ⑪Europe	163	21	44	49	277	17	14	113	62	207	103	55	0	270	423	10	47	4	62	

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



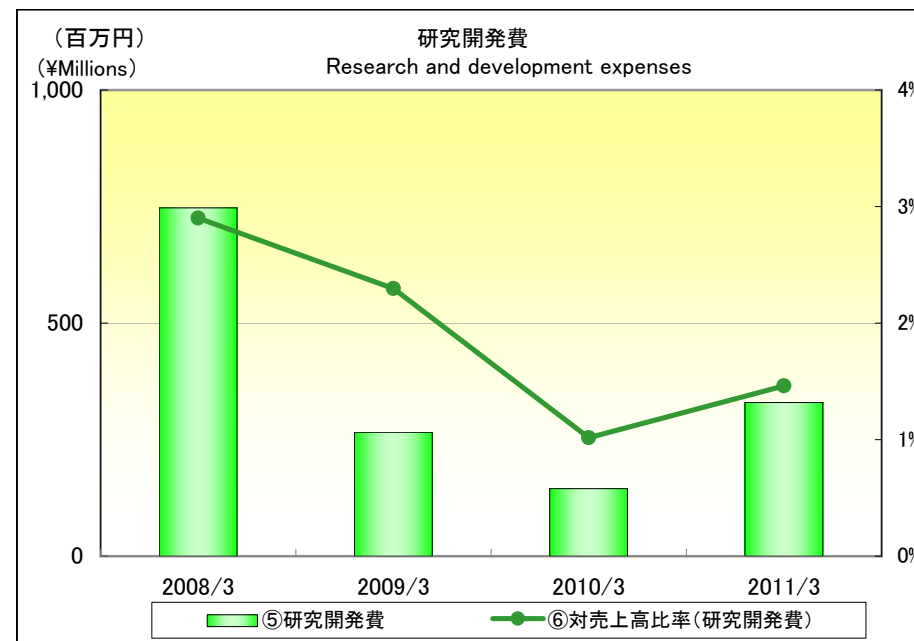
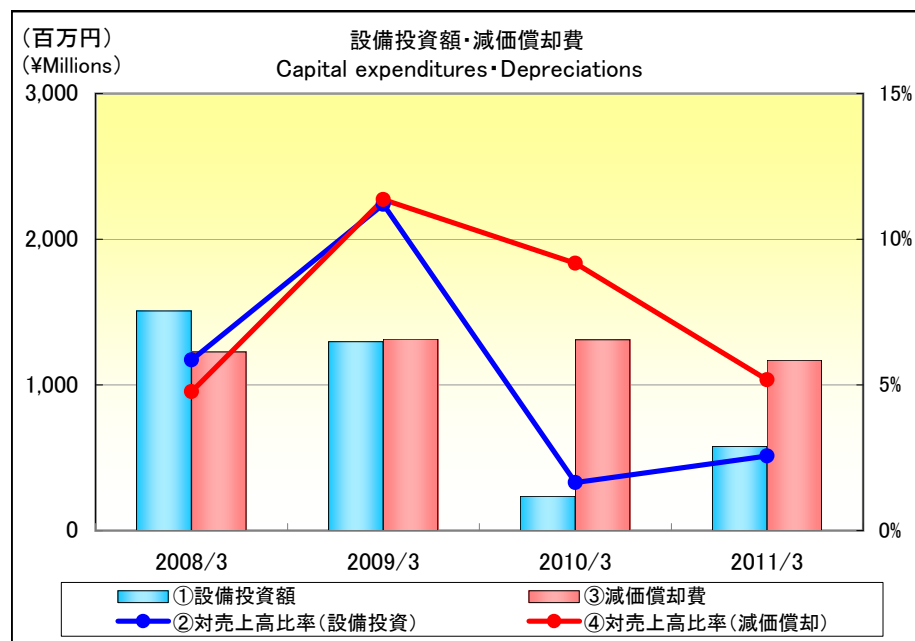
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3			
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	3Q累計
受注高合計 Total order received	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	13,210
半導体製造用等精密金型	1,679	1,275	498	314	3,767	961	976	1,383	1,951	5,273	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438	1,558	1,236	2,263	5,058
① Precision molds																			
半導体製造装置	2,166	1,431	-82	376	3,892	1,217	1,433	2,618	3,255	8,524	4,539	1,784	1,622	1,800	9,746	2,128	998	3,191	6,318
② Semiconductor manufacturing equipment																			
LED樹脂封止装置・金型	492	376	234	372	1,477	311	395	1,138	827	2,673	1,546	465	454	335	2,801	227	348	289	865
③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED																			
ファインプラスチック成形品	296	326	301	288	1,212	295	264	267	282	1,110	316	327	326	327	1,298	350	307	309	968
④ Engineering plastic molded products																			
月平均	1,545	1,137	317	450	863	929	1,023	1,802	2,105	1,465	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774	1,422	964	2,018	1,468

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3			
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	3Q累計
受注高合計 Total order received	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	13,210
日本 ⑤ Japan	1,178	1,024	966	742	3,911	910	863	1,229	1,400	4,404	1,038	781	853	875	3,548	821	906	963	2,691
アジア太平洋 Asia pacific	3,339	2,026	-47	578	5,897	1,590	2,083	3,995	4,801	12,471	7,753	2,893	2,825	3,311	16,783	3,356	1,960	5,016	10,333
(内 台湾) ⑥ Taiwan	1,277	1,135	-307	118	2,223	627	667	1,858	1,823	4,976	2,863	992	921	913	5,691	615	642	602	1,859
(内 韓国) ⑦ Korea	70	100	61	32	266	75	97	31	160	364	546	415	395	277	1,635	435	375	219	1,031
(内 中国) ⑧ China	854	404	18	254	1,531	415	764	663	1,507	3,351	2,456	376	907	1,198	4,938	1,801	746	-8	2,539
(内 その他アジア) ⑨ Other asia	1,136	386	180	172	1,875	471	554	1,442	1,310	3,778	1,886	1,108	601	921	4,518	503	196	4,202	4,902
米州 ⑩ America	39	386	-22	7	410	175	74	73	93	417	168	268	95	90	623	44	19	27	91
欧州 ⑪ Europe	78	-27	55	23	130	109	48	108	20	287	29	188	84	26	329	43	4	46	94

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結) 決算期		(Consolidated)				(単位:百万円/¥Millions)
		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2011/12
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	2,587	606	2,494	5,571	788
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,083	-1,490	-290	-620	297
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-1,947	1,972	-2,733	-3,808	-1,997
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	3,351	4,399	3,836	4,933	3,966
設備投資額	①Capital expenditures	1,508	1,296	236	578	850
対売上比率	②Ratio of sales	5.86	11.19	1.65	2.56	6.81
減価償却費	③Depreciations	1,227	1,315	1,309	1,170	844
対売上比率	④Ratio of sales	4.76	11.36	9.17	5.18	6.76
研究開発費	⑤Research and development expenses	747	266	145	330	191
対売上比率	⑥Ratio of sales	2.90	2.30	1.02	1.46	1.53